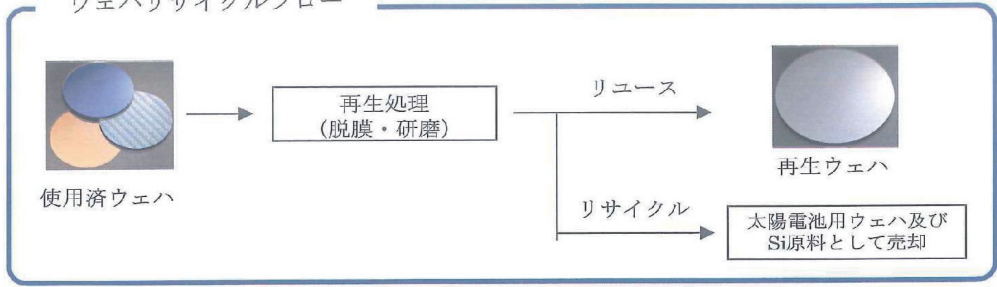


## 技術情報シート

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 技術の名称              | 半導体製造装置用ダミー・モニターウェハ(200mm、300mm)のリサイクル技術                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. 技術の内容              | 半導体製造工程で使用しているダミー・モニターウェハのリサイクルを可能としています。<br>再生研磨量を最小化する事で利用回数の増加、新品ウェハ購入量削減に貢献致します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. 技術の概要              | <p>【技術の目的・用途】</p> <p>半導体製造工程のダミー・モニター用ウェハにおいて、使用後の付着膜を独自のケミカルで除去し、廃棄されていたウェハのリサイクルを実現します。更に表面ダメージ層を薄表研磨で除去し、ウェハの長期再利用を実現します。<br/>また再生できないウェハは太陽電池用ウェハ及び Si 原料として活用致します。</p> <div style="text-align: center;">  <pre> graph LR     A[使用済ウェハ] --&gt; B[再生処理<br/>(脱膜・研磨)]     B -- リユース --&gt; C[再生ウェハ]     B -- リサイクル --&gt; D[太陽電池用ウェハ及び<br/>Si原料として売却]             </pre> <p>ウェハリサイクルフロー</p> </div> <p>技術の目的・用途、技術の特長、実績、価格</p> <p>【特長】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 付着膜の分析と高選択性エッチング液の開発技術</li> <li>② 薄表研磨（自社開発の枚葉研磨技術）</li> <li>③ 短納期でのご返却（ウェハ予備在庫の最少化を実現）</li> </ol> <p>【実績】</p> <p>日本国内、中国、台湾等の各半導体メーカー様</p> <p>【価格又はその問い合わせ先】</p> <p>お問合せ先：株式会社新菱</p> <p style="padding-left: 40px;">ウェハテクノ事業部門 企画営業部</p> <p style="padding-left: 40px;">担当 小西 伸清</p> <p style="padding-left: 40px;">電話番号 093-643-2778</p> <p style="padding-left: 40px;">Mail 6008513@shinryo-gr.com</p> |
| 4. 技術の分類              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ①用途分類                 | リサイクル(マテリアル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ②対象廃棄物                | 電子製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③提供役務                 | その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. 本技術に関するサービス提供が可能な国 | アジア地域(中国、台湾、韓国、シンガポール)を中心に全世界可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 検索キーワード            | ウェハ、リサイクル、再生、研磨、洗浄、ダミー、モニター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. 問合先窓口・担当者          | 上記 3. 【価格又はその問い合わせ先】をご参照下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |